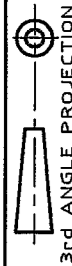


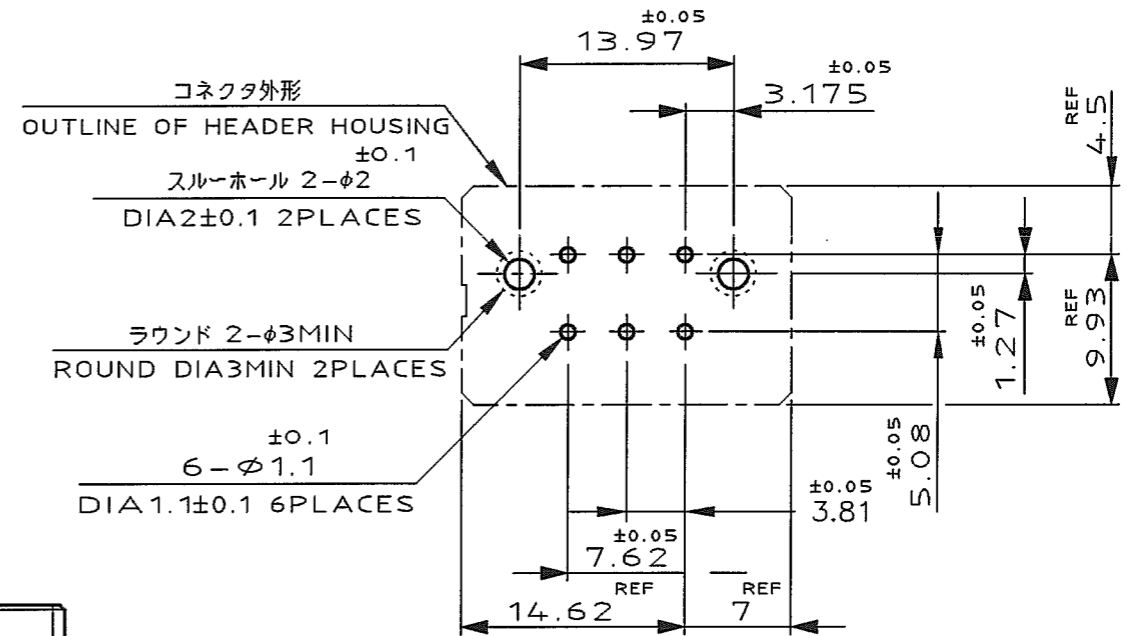
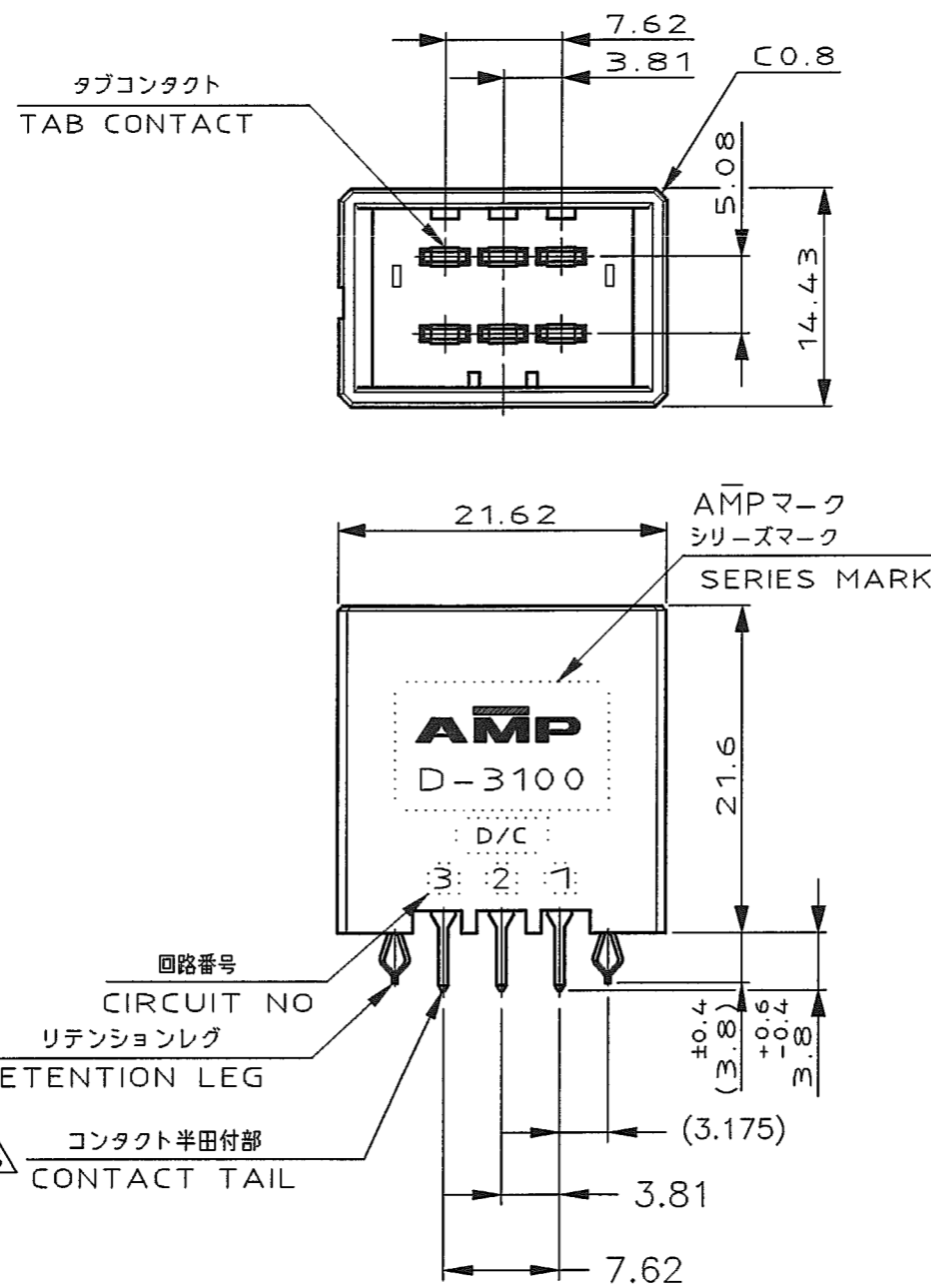
NUMBER 178323



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- ~~FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
+ ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178323-5
△6	△3	178323-3
△6	△2	178323-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	DOUBLE ROW (D-3100)		
mm(AWG -)	mmφ		DYNAMIC CONN. 6POS. VERTICAL HDR. ASS'Y		
MATERIAL	FINISH	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	NUMBER
SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	10%以下: ±0.3 10%超 30%以下: ±0.4 30%超 100%以下: ±0.5 角 度: ±3'	A3	J	C-178323
DR. N. Matsubara 15 FEB 91	DE. N. Matsubara 15 FEB 91	SCALE	REV.	SHEET	
CHK. T. Obata 21 MAY '91	APP. S. MANABE 21-MAY-'91	2-1	D1	1 OF 1	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)